# 鉛フリー対応・混載基板後付用 半自動バッチ式 局所ハンダ付装置・Jade-MK - 200S

高品質な部分ハンダ付を可能にするセレクティブ方式を採用! 最大457×508mmの大型基板に対応するバッチ式最新装置登場!

### 特徵

極細3軸(X-Y-Z)可動ノズルにより、ポイントハンダ付を行うセレクティブ 方式を採用しているため、基板毎の噴流マスク(多点噴流ノズルパレット) を製作する必要がありません。

新開発のAP-1シングルノズルにより、7mm高さまで噴流させる事ができます。またノズルの周辺部から窒素(N2)ホットガスを噴出させる事により、不活性雰囲気内でのクリアなハンダ付を実現します。

狭ピッチのコネクタでも、噴流波の表面張力により、余分なハンダを落としながら引きハンダできるので、ブリッジの少ない、高品質なフィレットが形成されます。

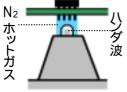
最大457×508mmの大型基板まで対応可能。またダイレクトティーチングによる簡易プログラミングが作業効率を高めます。



## AP-1/ズルによる高精度ハンダ付

ノズル周辺部から噴出される窒素(N2)ホット エアーがプリヒート効果を生み、不活性雰囲 気内でヌレ性の良い高品質なフィをレットを 形成します。



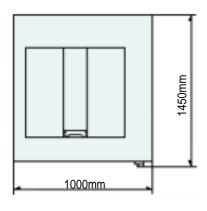


#### 主な仕様

装置外形寸法/重量	(W)1,000×(D)1,450×(H)1,210mm / 約300kg
対応基板	最大寸法:508×457mm/高さクリアランス:上下面とも40mm
窒素(N2)供給圧	4bar(56psi) N₂純度∶99.995%以上(ノズル周辺∶100ppm)
窒素(N2)消費量	5~50リットル / 分
電源·消費電力	200-240V、 単相∶300VA
フラクサー	ドロップジェットフラクサーによる局所(マスクレス)スプレー塗布
フラックス塗布径・速度	4.0~6.0mm · 50ドットノ秒
ハンダ容量	約12kg
データ入力	ダイレクトティーチングによる簡易座標入力(最大2,000プログラム)

#### 装置外形寸法





## 内部機構(ドロップジェットフラクサーと噴流ハンダ付ユニット)

